



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110429000
2011 年 4 月 29 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

STATSChipPAC 社製造 PBGA パッケージ 一部製品 代替 Substrate 部材追加のご案内

平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

日本での震災は、TI 美浦工場（茨城県、東京の北東 40 マイル(64km)）被害に加えて、弊社 IC パッケージ供給チャンネルにも一部影響を与えました。TI は一日も早い供給フローの正常化に向け、他供給業者からの支援の下懸命に作業しております。

今回のお知らせは、BGA パッケージ Substrate 代替部材追加についての連絡になります。お客様への供給停滞を最小限にとどめる為にも、本通知記載の対象製品について追加部材の認定を迅速に実施してまいります。

TI は現行最善の情報及び知識に基づき本通知に盛り込むべく全ての方策を行っていますが、再度変更追加があった場合には、本通知の更新にて連絡させていただきます。

次ページに詳細を掲載いたしました。お客様におかれましては、本通知発行日より **21** 日以内に本通知受領のご確認をお願いいたします。TI は、供給遅延を最小限にとどめるために、5 月の出荷が開始されるべく追加部材認定を実施する予定です。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業あるいは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	STATSChipPAC 社製造 PBGA パッケージ 一部製品 代替 Substrate 部材追加 現行 : 認定 Substrate 変更後 : 認定 Substrate, Doosan 社製 Substrate			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	5月の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input checked="" type="checkbox"/> 計画	<input type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容 : 弊社 ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト)/HPA(ハイパフォーマンスアナログ) STATSChipPAC社サイト製造 PBGAパッケージ 一部製品について、震災状況下での供給能力確保の為、代替Substrate部材追加の連絡になります。一部部材の供給制限のため、認定試験終了次第、本代替部材の追加変更は直ちに実施予定です。認定終了前のいかなる製品出荷についても、事前顧客承認が必要になります。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

<u>変更内容</u>	<u>現行</u>	<u>変更後</u>
Substrate 部材	認定 Substrate	認定 Substrate Doosan 社製 Substrate

理由 : 供給能力確保の為

製品表示

この変更による製品捺印、出荷ラベルの変更はありません。部材識別については、弊社標準のロット追跡及び製造手順によりトレーサビリティは確保されます。

対象製品リスト

対象製品名				
D610A003BZDP225	TMS320C6711DGDP200	TMS320C6713BGDP225	TMS320TC1110ZPC	TMS32C6713BGDPA200
OMAP5910JZDY2	TMS320C6711DZDP200	TMS320C6713BGDP300	TMS320TC1110ZPJ	TMS32C6713BZDPA200
TLK3134ZEL	TMS320C6711DZDP250	TMS320C6713BZDP225	TMS320TC1120AZDP	TNETV1055NNZDW
TLK3138ZDU	TMS320C6712DGDP150	TMS320C6713BZDP300	TMS32C6711DGDPA167	
TLK3142ZEL	TMS320C6712DZDP150	TMS320C6727ZDH300	TMS32C6711DZDPA167	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年7月20日
---------	----	---	----	------------

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qualification Device:	F761637AGXM	Substrate:	Doosan Substrate
Package:	PBGA	Site(s):	CPK

信頼性試験計画

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size
Material Property Comparison	Specification Review	per spec
Preconditioning	JEDEC L-4/260C	539
High Temperature Storage Life	150C, 600hrs Note (1)	45
Temperature Cycle	-55C/125C, 1000cyc	231
Temperature Humidity Bias	85C/85%RH, 600hrs Note(1)	77
UnBiased HAST	130C/85%RH, 96hrs	231

Note (1): Qualification Device release at 600hrs, other device Qual by Similarity/Bridge at 1000hrs